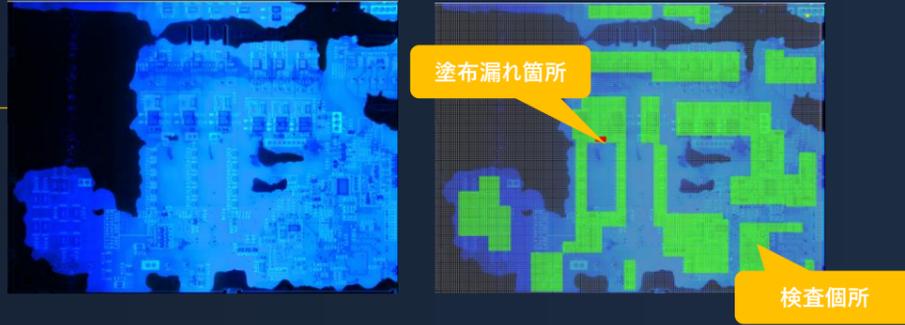


防湿コート検査例

あいまいな塗布境界は検査対象とせず
必要なエリアだけの色の差を計測することで
塗り残し・飛び散り共に検出できます。

※365nm UV-LED（追加オプション）が必要です



実装基板外観検査装置

L基板対応機種 新登場!

Summit シリーズ

- ✓ 0603部品から、印刷後はんだ、防湿剤塗布まで一台で幅広い検査対応力
- ✓ Mサイズ基板10秒以内の超高速検査タクトタイム
- ✓ 簡単設定でプログラム新規作成からわずか15分で検査スタート可能

多品種少量生産の現場で効果を発揮



項目		仕様		
装置名（型式）		コンベア搭載 Summit CV-M (WV-1806Q-330CV) コンベア非搭載 Summit CX-M (WV-1806Q-330CVX)	Summit TB-M (WV-1806Q-330)	コンベア搭載 Summit CV-L (WV-1806T-510CV)
検査対象	対応基板サイズ	50mm(X) 50mm(Y) - 330mm(X) 250mm(Y) 基板厚 0.4mm - 3.0mm		50mm(X) 50mm(Y) - 510mm(X) 460mm(Y) 基板厚 0.3mm - 8.0mm
	検査対象部品	最小サイズ：0.6mm(X) 0.3mm(Y) / 最大高：20mm / 最大部品数：無制限		
	主要検査項目	部品有無、極性、ズレ、裏マウント、誤部品、はんだボール、ブリッジ、色違い、印刷後はんだ無しカスレ、防湿剤塗りモレ、飛び散り、気泡etc. 1D/2D バーコード読み取り（オプション対応）		
光学系	カメラ	1,800万画素 USB3.0 CMOS カメラ 4 台		1,800万画素 USB3.0 CMOS カメラ 3 台
	レンズ	焦点距離6mm F1.8 解像度5Mpixel		
光学分解能		約37μm/pixel		
検査所要時間		5秒-20秒 (検査面積・メッシュサイズにより可変)		5秒-30秒 (検査面積・メッシュサイズにより可変)
照明		高輝度白色フラットLED×4方向 追加オプション：365nm UV-LED×2方向		
制御PC		CPU: Intel Core-i5 Memory: 8Gbytes OS: Windows10		
モニター		24inch Full-HD (HDMI接続)		
電源		AC100~240V(50/60Hz)(I) / DC24V 42W max(EU)		
動作温度範囲		5°C~40°C		
装置サイズ		横幅：640mm(コンベア長は別途御指定) 奥行：1200mm 高さ：1250mm 本体重量：約85Kg (CVX) 本体重量：約120Kg (CV)	横幅：560mm 奥行：826mm 高さ：420mm 本体重量：約20kg	横幅：1200mm(コンベア長は別途御指定) 奥行：1780mm 高さ：1262mm 約200Kg (CV本体重量)

弊社に関する情報のご案内

Wing Vision ホームページ <https://www.wvision.co.jp/>

お客様サポート

✉ support@wvision.co.jp ☎ 0263-88-0088 9:00~18:00
(土日祝日 年末年始 GW 夏季休業を除く)

- ・価格、サブスクリプションについては下記にございます代理店にお問い合わせください
- ・本カタログに掲載の製品写真は一部実製品と異なる場合があります
- ・本カタログに掲載の仕様は一部実製品と異なる場合があります

サンプル検証・お見積りのご依頼は代理店へ

挿入部品・はんだ面対応基板検査モデル

オフライン、軽量卓上型。
ラインに組み込まないことで複数ラインの検査ができます。

Summit TB-M

- DIP後の挿入部品・はんだ面の検査が簡単にできる
- リフロー後の実装部品検査が短時間でできる
- 汎用的に目視検査のサポートとして使用できる
- M基板対応



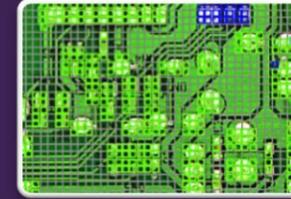
スライドテーブルを閉める
だけで検査をスタート



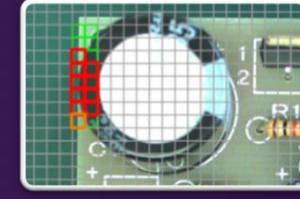
作成管理が大変だった従来のパーツライブラリが不要！

簡単に現場で使いこなせる自社開発ソフトウェア「メッシュマッチング」*を搭載。
「メッシュマッチング」は、画像に一律の大きさのメッシュを掛け、良品画像と検査画像の同位置を比較。
しきい値未満であればNG判定する検査方法です。専門的なスキルが不要で短時間で設定完了できます。

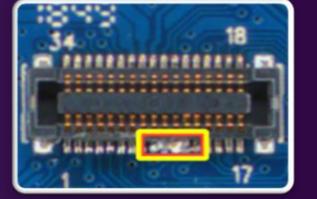
【検査例】



【はんだ面検査】



【挿入部品】



【実装部品検査】

* 日本国特許第6233824号

ソフトウェアのバージョンアップ体制をご用意。導入後もソフトウェアの機能を進化させていきます。

リフロー前専用外観検査モデル (PRI : Pre-Reflow Inspection)

インラインモデル。
コンベア内蔵タイプと既存コンベアにレイアウト変更を必要とせず
ビルトインできる、「マタギ」タイプの2種類。
検査ユニットが後方にスライドし、基板へのアクセスが簡単にできます。

Summit CV-M / Summit CX-M Summit CV-L

- はんだ接合前に異常を検出、修理の手間や二次不良をなくせる
- 前工程の装置の不調をいち早く検知、メンテナンスに役立てる
- 機種切り替え後の一枚目確認で前回との差を簡単に確認できる
- M基板(330シリーズ)、L基板(510シリーズ)対応



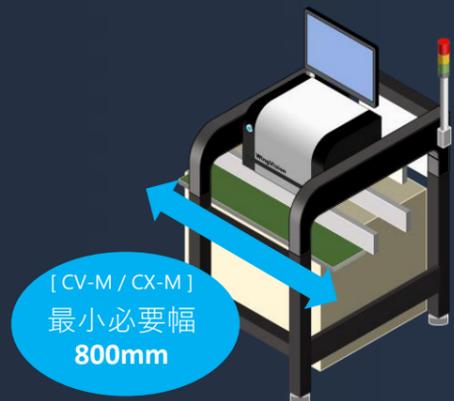
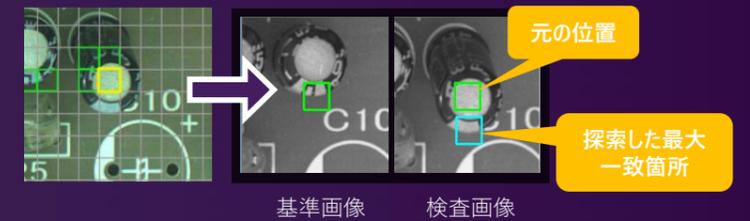
らくらく基板アクセス

「スライドヘッド」機能* 搭載で、ズレた部品の修正や、
試作時の手寄せ、温度プロファイル取りなどの作業も
支障なく行えます。

* 特許出願中

部品ズレへの追従性と高い検出精度を両立

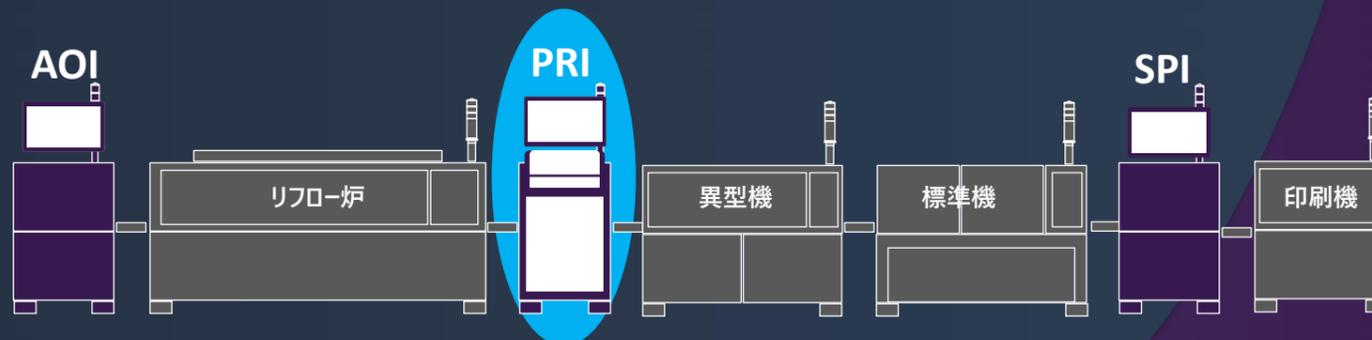
一般の検査装置が苦手とする「位置精度のない部品をOKにする」こと
がメッシュマッチングには可能です。個々のメッシュが許容された範囲で
周辺を探索し、最大一致するパターンを探すことで柔軟性と高い検出
精度の両立を実現しました。



【CV-M / CX-M】
最小必要幅
800mm

既存の作業用コンベアをそのまま活用し
レイアウト変更なしですぐに設置可能。

リフロー前で搭載検査を行う事でAOIの負担も軽くなり、修理コストの低減だけではなくプログラム作成時間も含めた
総合的な設備効率の向上が期待できます



AIによるパラメーター自動検査設定

良品基板と未実装基板の組み合わせで検査の必要
な場所に必要なパラメータを全自動で設定する
「AI-Mesh」機能を搭載。
設定時間短縮 + 高精度の設定を可能にしました

